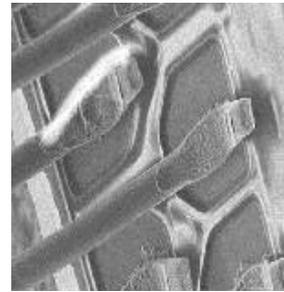
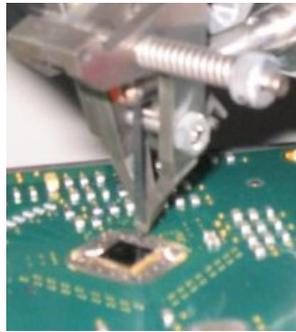
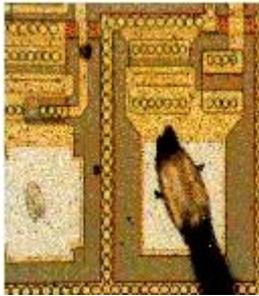


## COB-Technik - Bondtechnik

Unter dem Begriff Bonden versteht man das Verbinden zwischen Materialien / Komponenten und Anschlusselementen von einer zur nächst höheren Verdrahtungsebene, bei der Herstellung elektronischer Bauteile.

- Eine elektrische Kontaktierung zwischen den Chipanschlussflächen des Dies und den Trägerstreifen (Leadframe). Vorherrschend sind Drahtkontaktierverfahren.



- Wir und unser Partner sind ein Dienstleistungsunternehmen, das auf die Mikroverbindungs- technik spezialisiert ist.
- Wir betreuen und unterstützen Sie von der Projektierung bis zur Serienproduktion. Wir stellen sämtliche Dienste für ein wirtschaftliches Outsourcing für Modul- und Hybridtechnik zur Verfügung.
- Der Schlüsselbereich ist Bonden auf PCB (FR2, FR4), auf Folie sowie auf Keramik. Unsere Stärke liegt bei kleinen bis mittleren Stückzahlen.
- Die Vorteile, technisch kleinste Abmessungen zu realisieren und neben der Raum- einsparung durch kürzere Leitungslängen zusätzlich Spielraum für höhere Übertragungsfrequenzen zu erreichen, eröffnet innovativen Produkten neue Möglichkeiten.
- Der Einsatz dieser Technologien ist für Low Cost Produkte genauso interessant wie für absolute High Tech Anwendungen.
- Wir sind Ihr Spezialist für Bond-Technologie und Zulieferer von Komponenten.

**Preise auf schriftliche Anfrage, auch online unter Kontakt "Online Anfrage, sowie Fax Anfrage" möglich.**

**Eine Anfrage lohnt sich bei uns immer !!!**